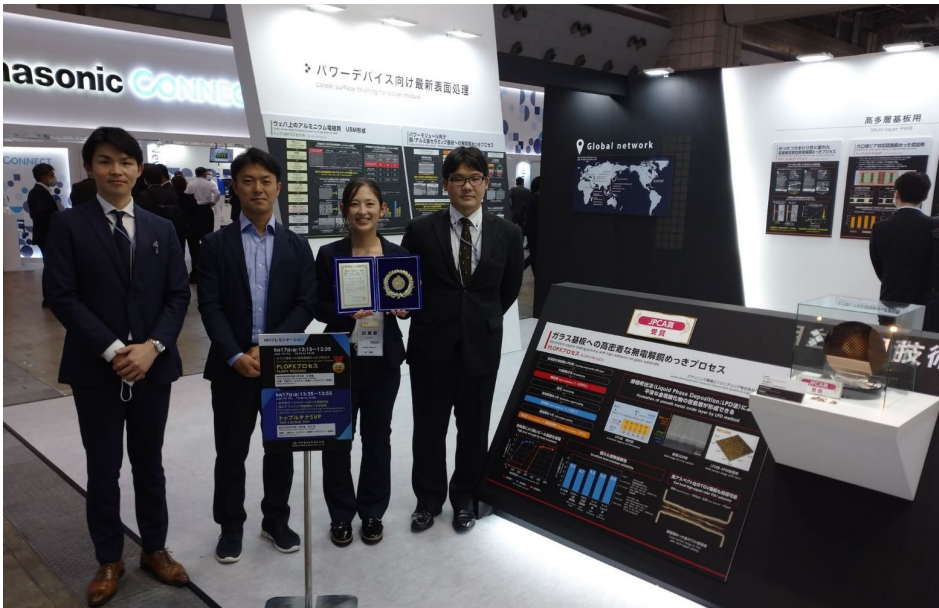


# PLOPXプロセスが「第18回 JPCA賞(アワード)」を 奥野製薬工業と共同受賞

ガラスに銅めっき加工することで、難めっき素材への回路形成等が実現できることが高評価



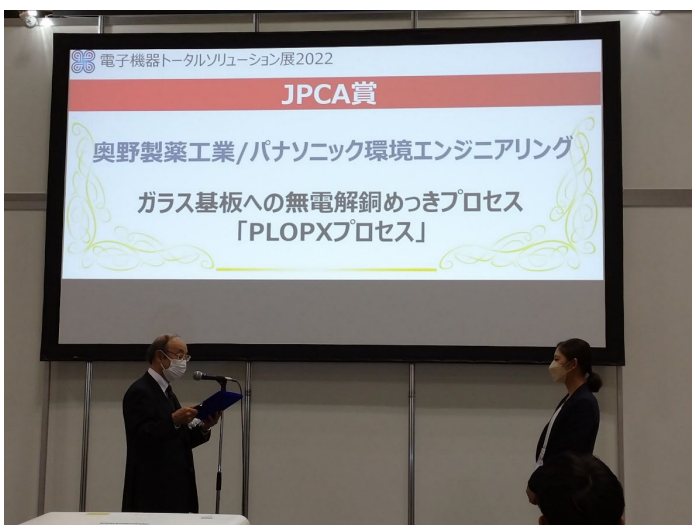
当社ではデバイス工場向けに薬液の開発・販売を行っておりますが、今回奥野製薬工業と開発した「PLOPXプロセス」は、難めっき素材である「ガラス」に対して「高密着な銅めっき」を可能にし、次世代高速通信(5G、6G)へ対応した基板等への展開が期待されると評価され、一般社団法人日本電子回路工業会(以下、「JPCA」)より「第18回JPCA賞(アワード)」を受賞しました。

JPCA賞(アワード)は、「独創性(独自性・オリジナリティ)」、「産業界での発展性・将来性」、「信頼性」、「時世の適合性」が選考基準となっています。

今回の受賞は、技術の価値や優位性が業界に認められたことを意味し、国内外に広く周知される大変名誉ある賞を受賞出来ました。

## 【特徴】

- ・オールウェットプロセスのため、スパッタ法では困難だった“両面一括処理”や“複雑な形状への処理”に対応可能
- ・高アスペクト比のTGV基板も処理可能



ガラスに銅めっきを施したウエハーを展示

## 【関連情報】

▼PLOPX プロセスの技術情報はこちら

[https://panasonic.co.jp/hvac/peseng/technology/chemical/pdf/plopx\\_01.pdf](https://panasonic.co.jp/hvac/peseng/technology/chemical/pdf/plopx_01.pdf)

▼技術紹介 ケミカル サイトはこちら

<https://panasonic.co.jp/hvac/peseng/technology/chemical/>

▼本件に関するお問合せはこちら

<https://panasonic.co.jp/hvac/cgi-bin/peseng/inq.cgi>